

MICAおよび PL-R製品ハウジングとPCBキャリア変更のご案内

お客様各位 御中

拝啓、貴社益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠に有り難うございます。
早速ではございますが、上記の件につきまして連絡申し上げます。
宜しくご査収・ご理解の程、お願い申し上げます。

作成日：2025/8/03

作成：プロダクトマーケティング

文書番号：PM-S-250803

敬具

記

●対象型番

ハーティング社MICA-RシリーズおよびPiLink社PL-Rシリーズをご使用のお客様が対象です。

●変更箇所

筐体(ハウジング)とステッカーおよびPCBキャリアの仕様変更

●変更理由

放熱特性の向上とラズパイ5製品対応キャリアボードとの部材共通化によるものです。

●変更点

以下のような変更点となります。

- 筐体とステッカーおよびPCBキャリアの変更



●品質・性能

変更された仕様により機能等の変更はありません。筐体の変更により放熱特性は向上します。保管/使用温度範囲に変更はありません。

●型番変更の有無

型番の変更はありません。

●実施

- 2025年8月より随時対応予定です。変更時点は、ロット内で混在する可能性がありますのでご了承ください。

PiLink株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-6 VORT新横浜 9階 電話：045-286-5695 / FAX：050-6883-8687